



BUSINESS REPORT 2014

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

社長あいさつ

2014年3月期の当社グループを取り巻く環境は、米国、欧州、日本など主要先進国で景気回復の兆しが見られる一方で、中国をはじめとするアジア新興国では経済成長の鈍化が見られました。当社の主要な市場である世界半導体市場は、パソコンの世界出荷台数が前期比で大幅な減少となりましたが、スマートフォンやタブレット(多機能携帯端末)関連需要の拡大により回復局面にあります。一方、半導体の基板であるシリコンウェハー市場は、面積ベースでは横ばい基調にあるものの、価格の下落により販売金額ベースでは引き続き低減傾向が続いております。

こうした状況下、当社グループでは一丸となって売上拡大とコスト削減に努めましたが、2014年3月期の連結業績は、売上高27,492百万円(前期比15.2%減)、営業利益1,300百万円(前期比62.8%減)、経常利益1,535百万円(前期比60.1%減)、当期純利益799百万円(前期比64.0%減)となりました。

当社グループでは厳しい事業環境の中、2014年3月期は全社横断的で大幅なコスト低減を実現しました。お客様との関係では、ディスク事業やCMP事業においてお客様から表彰を頂くとともに、お客様から定期的にフィードバックされるサプライヤーレーティングや当社が毎年実施しているお客様満足度調査でも良い評価を受けるなど、経営方針のひとつとしてここ数年掲げている「お客様目線の実践」が確実に浸透しつつあります。

既存の事業領域では市場が成熟化し競争が激化しつつあります。この事業領域でマーケットシェアを堅持する一方で、新規事業や新規用途の開拓が従来にも増して重要になっております。今期はここ数年の活動で育成した新規事業に、さらに注力すべく新規事業本部を新設し、また従来企画本



部傘下であった事業企画部を社長直下に変更するなど組織機能面でより素早く機動的に対応すべく体制を強化しております。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を頂きますようお願い申し上げます。

2014年7月
代表取締役社長

関 敬史

プロフィール

当社の創業以来蓄積されたノウハウと研究開発力から生まれた当社製品の数々は、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、半導体チップの多層配線に必要なCMP(化学的機械的平坦化)、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっております。

最近では、LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品等の硬脆材の表面加工分野やその他様々な表面加工のニーズに独自のソリューションで応える取組みを積極的に進めております。また、溶射技術や装置に最適な溶射材の開発・商品化で新分野を開拓しております。

目次

社長あいさつ	1
当社の経営方針	3
研究開発活動	7
暮らしの中のフジミ	11
製造工程の中のフジミ	13
経営指標	15
連結貸借対照表	19
連結損益計算書	21
連結包括利益計算書	21
連結キャッシュ・フロー計算書	22
会社データ	23
株式情報	24
グローバル展開	25

Message from the President

During the fiscal year ending March 31, 2014, Fujimi Group's overall operating environment was characterized by contrasting economic outlooks. Major industrial countries including the U.S., Europe, and Japan saw signs of economic recovery, but China and other emerging countries in Asia showed a slowdown in economic growth. In our main market, the global semiconductor market, there was a big drop in global shipments of PCs compared to the previous fiscal year, but the market is recovering due to increased demand for smartphones and tablets, multifunctional mobile terminals. Meanwhile, the market for silicon wafers, which are used as semiconductor substrates, has remained at a steady level on an area basis, but overall sales have continued to decline due to a fall in sales prices.

Given these conditions, and despite the concerted efforts of the Fujimi Group to increase sales and reduce costs, the consolidated results for the fiscal year ending March 31, 2014 were as follows: 27,492 million yen in net sales, 15.2 % decrease from the previous year, 1,300 million yen in operating income, 62.8 % decrease from the previous year, 1,535 million yen in ordinary income, 60.1 % decrease from the previous year, and 799 million yen in net income, 64.0 % decrease from the previous year.

In this difficult business environment, Fujimi Group implemented significant group-wide cost reduction measures during the fiscal year ending March 31, 2014. And in the area of customer relations, we have been commended by customers in our Disk and CMP businesses and evaluated favorably in supplier ratings regularly submitted by customers

and the customer satisfaction surveys we conduct every year, showing that the management policy of "applying the customer's point of view" we have adopted for the past few years is steadily permeating the Group.

The market has matured and the competition is fierce in existing business fields. It is now more important than ever to develop new businesses and applications while firmly maintaining our market share in existing business fields. In the present fiscal year, we are enhancing our structure so that we can take more expeditious action as an organization, creating a New Business Department to focus even more on the new businesses we have actively cultivated over the last few years and putting the Business Planning Department under the direct control of the President instead of the supervision of the Planning Division.

We are grateful for your business and ask for your continued understanding and support.

July 2014

Keishi Seki, President

Profile

Drawing on the know-how and R&D capabilities the company has accumulated since its founding, we have developed numerous products essential for cutting-edge industries with high-precision polishing needs, including mirror polishing of semiconductor substrates like silicon wafers, CMP (Chemical Mechanical Planarization) required for the multilayer wiring of semiconductor chips, and computer hard disk polishing.

Recently, we have been actively pursuing unique solutions to address surface finishing needs for hard and brittle materials, such as parts used in LEDs, displays, and power electronics, as well as other types of materials. We have also been exploring new fields through the development and commercialization of optimal thermal spray materials for thermal spray technologies and devices.

Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Research and Development Activities	8
Fujimi's Products and Technology in Everyday Life	11
Fujimi's Products are used for Manufacturing	13
Selected Financial Data	15
Consolidated Balance Sheet	19
Consolidated Statement of Income	21
Statement of Consolidated Comprehensive Income	21
Consolidated Statement of Cash Flows	22
Corporate Data	23
Stock Information	24
Global Expansion	25

当社の経営方針

はじめに

当社は「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理念を掲げ、創業以来一貫して製品の高品質化と安定供給に努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術水準の高度化に対して、迅速かつ確に対応し、「顧客満足度を高める質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことにより、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続き掲げてまいります。

企業理念

企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダーの信頼に応えます。

行動規範

- ・お客様の満足を常に考え行動します。
- ・問題の本質を追求し、迅速且つ確実に解決します。
- ・夢の実現に向け、熱意・誠意・創意をもってチャレンジします。
- ・ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

企業ビジョン

事業アイデンティティ

パウダー&サーフェイス分野で世界最高技術を提供し、理想とする「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが理想とする「エクセレントカンパニー」とは、業績が優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ・変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、生き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

企業文化ビジョン

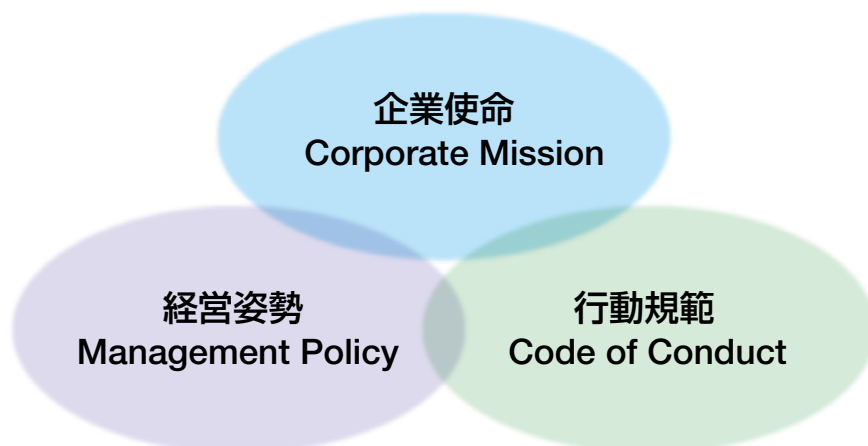
強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- ・自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ・仲間を大切に、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ・夢をいだき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します。

企業理念 Corporate Philosophy



Management Objectives

Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered on its base in powder technologies. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality

products, a manufacturing approach from which we have never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, “polishing our technologies and bringing people together,” which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain same.

Corporate Philosophy

Mission Statement

Our mission is to develop new, innovative technologies and applications with a commitment to environmental sustainability, thereby enabling the advancement of technology for the betterment of humanity.

Management Philosophy

- We adopt the customer’s point of view to create solutions that meet the customer’s needs and expectations.
- We excel in the ever changing business environment through innovation and continuous improvement.
- We adhere to rules and regulations and operate ethically, thereby strengthening our stakeholders’ confidence and trust.

Code of Conduct

- We act with customer satisfaction in mind.
- We strive to identify the cause of an obstacle and to resolve it quickly.
- We challenge ourselves to succeed with passion, sincerity and creativity.
- We respect each person’s ideas.
- We conduct ourselves with pride, honesty and integrity.

Corporate Vision

Business Identity

We offer the world’s highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an “excellent company.”

Being an “excellent company” means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing environmental impact as a member of a recycling-based society.

Corporate Cultural Vision

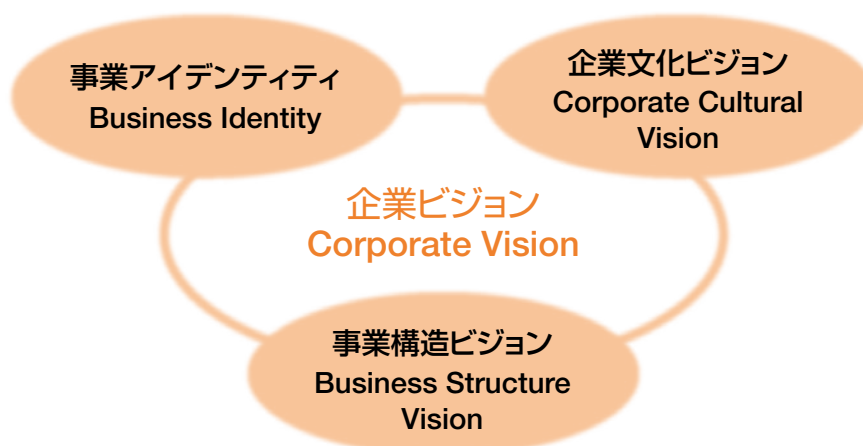
Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (Silicon and CMP) and non-semiconductor fields.

企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision



中長期的な会社の経営戦略

当社はバランス・スコアカード（BSC）の考え方を基に、2009年6月に2018年3月期を最終年度とする中長期経営計画を策定いたしました。この中長期経営計画は、3年を区切りとする3次の中期計画を基にして、数値的な定量的な計画だけでなく当社のありたい姿を含めた定性的な計画としています。

中期計画の第一段階は自己診断と成長のための基礎体力づくり、成長のための種まきにあて、第二段階はまいた種をきちんと育てる時期、そして第三段階は事業開花させ、実を収穫する時期、とそれぞれ位置づけています。

中長期計画の5年目のあたる当期は、第2次中期計画の「まいた種をきちんと育てる〈基盤強化〉」の時期に相当し、お客様のニーズを把握し、それを具現化し、より高い満足を提供する為、「お客様目線の実践」を経営方針に掲げ、展開してまいりました。その結果、お客様満足度と製品品質面において評価をいただいております。

当社はこれまで半導体市場を主たる事業領域としてまいりましたが、当社を取り巻く事業環境は大きく変化しております。当社が主に事業展開している半導体市場は、2008年のリーマンショックを発端とする世界同時不況により、携帯電話やデジタル家電など様々な商品の販売が失速し影響を受けました。その後、従来型パソコンの出荷台数は減少したものの、スマートフォンやタブレット（多機能携帯端末）関連需要の拡大等により半導体市場規模は回復し、再び成長の兆しを見せております。しかしな

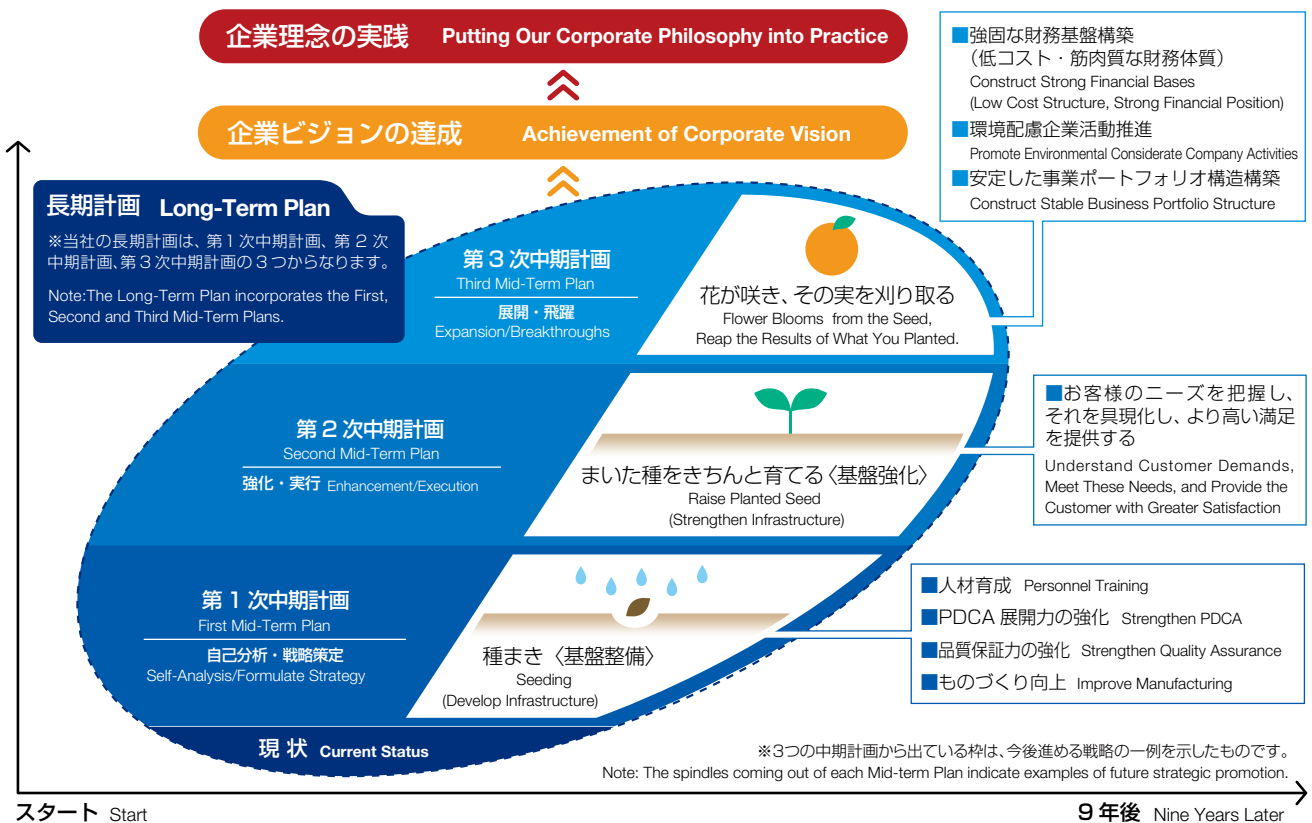
がら、当社が主力事業として研磨材を提供している半導体基板であるシリコンウェハーについては、面積ベースでは半導体市場同様に回復した後、現在は横ばい基調にありますが、単価は下落しており販売額の減少が続いております。このため、当社がお客様に提供する研磨材についても価格競争や使用量の削減の動きが高まっております。

こうした事業環境下で安定的かつ持続的な成長を遂げるためには、当社は特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要であると考えております。

そこで、当社は、企業ビジョンとして、「既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジし、半導体関連分野（シリコン・CMP）と非半導体関連分野の安定した事業バランスの構築を目指します」を掲げ、従来から推進しているシリコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5事業に加え、2014年4月の組織変更において「新規事業本部」を設置し、非半導体分野の新規事業の探索と育成のための推進体制を強化いたしました。

これらを通じて安定した事業構造を維持するため、将来的には事業構造比率として半導体関連比率50%、非半導体関連比率50%を目指しております。

また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策として具現化し、その成果については評価指標（KPI）によって定期的に進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦略を組織横断的に展開しております。



Mid-Long Term Management Strategy

Based on its core concept of a Balanced Scorecard (BSC), Fujimi has formulated a Mid-Long Term Management Plan to guide the Company from June 2009 through the fiscal year ending March 31, 2018. The plan is separated into three parts and is based on three successive mid-term plans. In addition to quantifiable objectives, the plan includes qualitative elements that describe the type of organization Fujimi aims to become.

The first stage of our mid-term plan involves self-analysis and establishing the foundations for growth - "seeding" our operations. The second stage involves raising the planted seeds, while, in the third stage, we plan to reap the results of the seeds of progress we have planted.

Now in the fifth year of our Mid-Long Term Management Plan, we are in the second phase - that of raising the seeds we have planted (strengthening infrastructure). In this phase, in order to understand customer needs, specify these needs, and provide the customer with greater satisfaction, we have advocated and developed the "practice of looking through the eyes of customers" as a management policy. As a result, we have been highly credited with both customer satisfaction and product quality.

We have been conducting our business mainly in areas in and around the semiconductor market. However, the business environment surrounding us has changed greatly. The semiconductor market, which is our main business field, was severely impacted by the global recession triggered by the bankruptcy of Lehman Brothers in 2008, as sales of mobile phones, digital home electrical appliances, and various other products stalled. Afterwards, despite a slump in the shipments of conventional computers due to increasing demand for smartphones and tablets (multifunctional mobile terminals), the semiconductor market recovered in size and is once again showing signs of growth. Just like the semiconductor market,

sales of silicon wafers that are used as semiconductor substrates - and for which we provide abrasives as a main line of business - have remained at a steady level after some recovery in some regions, but overall sales have continued to decline due to a fall in unit prices. To sum things up, price competition has been intensifying for the abrasives that we provide to customers, in an environment where customers are reducing the use of abrasives.

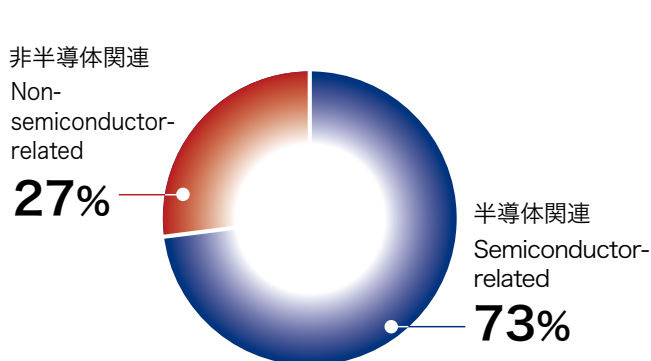
Furthermore, ensuring stable and sustainable growth under such business conditions requires the Company to adjust its business structure along the lines of specific businesses and applications.

Therefore, we are pursuing a corporate vision of "strengthening existing business, while also taking a proactive stance toward upcoming challenges in new fields with the aim of establishing a stable balance between semiconductor-related businesses (Silicon and CMP) and non-semiconductor-related businesses. "For this reason, in addition to the five areas we have pursued to date (Silicon, CMP, Disks, Specialty Materials and Thermal Spray Materials), we established a "New Business Division" in the reorganization of April 2014 to strengthen the promotion system for exploring and fostering new businesses in non-semiconductor fields.

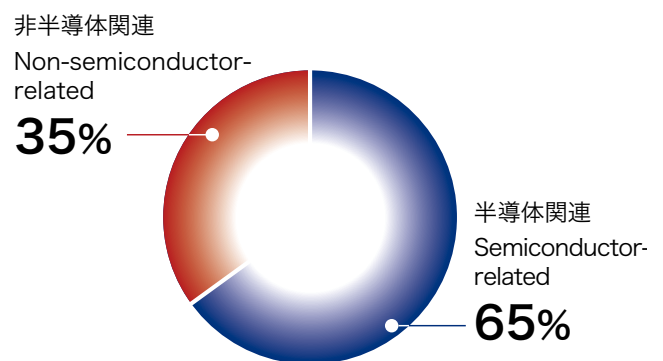
Through these efforts, we aim to achieve a business structure in which 50% of our revenues come from semiconductor-related businesses and 50% from non-semiconductor-related businesses.

On a companywide level, we have established strategic targets for the five businesses, by creating specific measures and defining key performance indicators to monitor progress on a quarterly basis. We are implementing operational strategies across the organization, based on a system of clearly defined responsibilities.

事業構造ビジョン (売上構成比) Business Structure Vision (Composition of Sales)



2018年3月期 (既存事業のみ)
Fiscal year ending March 31, 2018
(Existing business only)



2018年3月期 (新規事業分を含む)
Fiscal year ending March 31, 2018
(Including new business)

研究開発活動

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に積極的に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコアとなる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査企画機能の強化に努めています。

シリコンウェハー

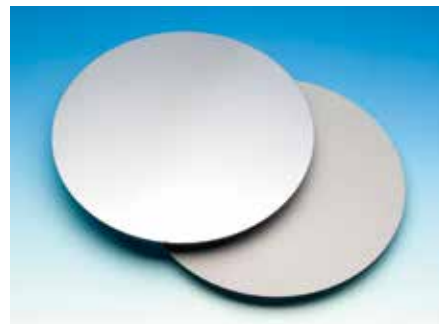
シリコンウェハー 300mm の需要拡大、デザインルールの超微細化に伴い、超精密研磨の要件である、①平坦化、②無欠陥化、③平滑化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強くなっています。

平坦化と生産性向上が求められている、ラッピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工精度と加工歩留まり向上のために、砥粒の細粒化に注力しています。

一次研磨工程用としては、ウェハー中心部から外周部まで超平坦に加工できるものや、生産性向上につながる高速ポリシング材にも、砥粒・添加剤技術を応用しながら開発に取り組んでいます。

最終仕上げ工程用では、1Xnm 世代のウェハー研磨用として、研磨後表面のナノ欠陥を激減した原子レベルの平滑性を実現するポリシング材やそれらを組み合わせた研磨材の開発を推進しています。

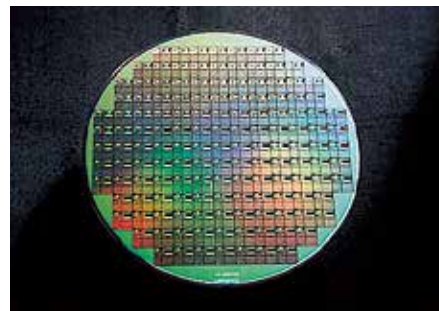
更には、近年次世代パワーデバイスとして SiC や GaN 系の半導体が注目されており、これらを研磨する研磨材の研究開発も進めており、一部については実用化にいたっております。



半導体デバイス

先端の半導体デバイスの微細化が進展し、テクノロジーノード20nm の量産とともに14nm 以降のデバイスの研究開発が進んでいます。微細化の進展に伴い、FinFET と呼ばれる新しい3次元構造のトランジスタが開発、量産されています。また、高密度化を目的に3次元にLSIを積層する、スルーシリコンビア (TSV) 技術の開発も進んでいます。これらの新トランジスタやTSVの形成においてもCMPプロセスの適用が検討されており、その範囲がますます広がっております。

当社では、従来の多結晶シリコン薄膜用やCu配線用にポリシング材を開発していますが、上記のようなCMPプロセスの用途の拡大に合わせ、FinFETトランジスタ用、TSV用などにおいて新たな研磨対象となる材料や構造に適用できるポリシング材の開発も始めています。当社では微細化、高密度化とともに高度化するお客様の要求にお応えするため、最先端の研磨装置、評価装置を活用すると同時に、当社の砥粒技術、ケミカル技術などを活かした研究開発を行っております。



ハードディスク

今後増大していくデジタルデータの要求量に対応するために、次世代ハードディスクの開発が加速しています。現在、ハードディスク基盤に求められる欠陥数・サイズの低減要求はさらに厳しくなっており、数nmレベルの欠陥が問題とされています。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動を実施し新商品の開発を推進しております。



Research and Development Activities

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its aggressive development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is core to our growth. We are working to strengthen our technology-based new business and topics research and planning function.

Silicon Wafers

In accordance with rising demand for 300 mm silicon wafers and shrinking design rules, demand is increasing for synthetic precision abrasives that are (1) flat, (2) free from defects (3) smooth, that (4) minimize contamination from trace metals and (5) improve manufacturing. We are focused on abrasive grain refinement to improve the processing accuracy and yield rate for lapping and silicon wafer slicing abrasives, which are also required for high-performance flatness and improved manufacturing.

For the primary polishing process, Fujimi is developing abrasives and additive technologies for high-speed polishing compounds, which are linked with productivity increases, as well as polishing compounds that can make wafers extremely flat from their center to periphery.

For the final finishing process, Fujimi develops polishing compounds that will reduce nano defects and achieve atomic level smoothness required in polishing next-generation wafers for 1Xnm devices, as well as polishing materials that combine such polishing compounds.

Furthermore, since the SiC and GaN related semiconductors are attracting attention as next-generation power devices and have already been put into practical use to some extent, we are promoting research and development of abrasives for polishing such semiconductors.

Semiconductor Devices

The micronization of cutting-edge semiconductor devices is progressing as 20 nm technology nodes are now being mass-produced, and research and development is moving forward towards 14 nm and smaller devices. Alongside the micronization trend, a new kind of transistor with a 3D structure, known as a FinFET, has been developed and taken to production. And, with the goal of higher densification, development of Through Silicon Via (TSV) technology that laminates LSIs in 3 dimensions is underway. We are exploring the application of CMP processing to these new transistors and TSV forming with the strong prospect of expanding its scope.

We have already developed polishing materials for polycrystal silicon films and Cu wiring, but for the expanded use of CMP processing as aforementioned, we have launched research into polishing materials that can be used with new materials and structures for FinFET transistors, TSV and so forth. At Fujimi, we are employing state-of-the-art polishing and evaluation equipment, and applying proprietary polishing and chemical technologies to research and development operations in order to meet customer demands for higher levels of micronization, densification and sophistication.

Hard Disks

Development of next generation hard disks has accelerated in order to handle the increased volume of digital data of the coming future. Today, demands for fewer and smaller defects are even stricter with hard disk substrates, as defects of just several nm in size are considered a problem. To meet these requirements, we are working on new product development through activities together with customers.

機能材

電子部品、自動車、レンズ等の業界における精密砥石、研磨布紙及び一般ラッピング・ポリシング関係を中心とした研磨材・機能性材の開発を推進しています。また、各種用途における開発力を強化し、お客様の潜在的なニーズまでも引き出し、的確な提案をすることにより、お客様の信頼を高めていくよう努めてまいります。

新規事業

半導体、ハードディスク用途など既存事業用途以外の新規用途（例：LED、ディスプレイ、モバイル用途など）で用いられる、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどの多種多様な一般工業用部品の研磨材等の開発に取り組んでおります。新規の用途では、研磨を新たに導入する業界も少なくなく、研磨材のみならず、用途に応じた装置や周辺消耗材の推奨も含めた、研磨プロセスの開発・提供も必要とされております。世界の様々な業界のお客様から寄せられる、新たな表面加工ニーズに、トータルソリューションでお応えしてまいります。



様々な産業



様々な課題



様々な加工対象



溶射材

省資源化、高効率化要求が高まっている現代社会において、航空機、半導体、一般産業機械など多岐にわたり高機能皮膜の要求は高まってきており、溶射皮膜の用途拡大が見込まれています。近年の溶射プロセスでも、高効率化、高品質化へ向け、低温化、微粉化をキーワードとした新技術が注目を集めています。これら市場の期待に応えるべく、新技術に最適な溶射材開発に重点を置き推進してまいります。



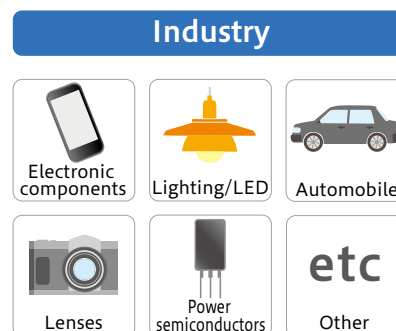
基盤技術・生産技術

基盤技術・生産技術部門では当社コア技術のさらなる強化に努めています。①ろ過・分級・精製、②パウダー、③ケミカルの3つのコア技術を中心に技術開発を進め、商品開発の加速、高性能化、新規事業分野への展開に貢献しております。

Specialty Materials

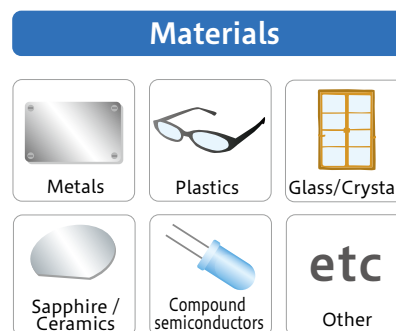
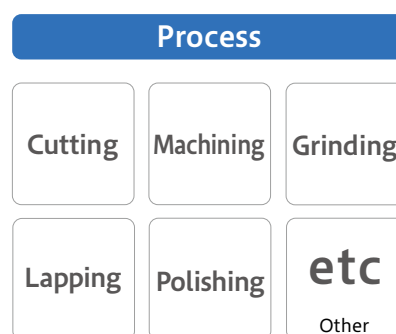
We are promoting the development of abrasives and specialty materials mainly on precision grinding wheel materials, coated abrasives and general lapping and polishing for the electronic components, automobile, lens and other markets.

Also, we will continue working to enhance customer trust by strengthening development capabilities in various applications, drawing out the potential needs of customers, and making sound proposals.



New Business

We are developing abrasives and other products for a wide variety of industrial components made of metal, plastic, glass and ceramic for new applications (e.g., LEDs, displays, mobile device, etc.) other than semiconductor, hard disk and other applications covered by current business. To speak to new applications, there are still many industries that have yet to invest in grinding and polishing, which makes it all the more necessary to develop and supply those processes and to recommend not only abrasives but also application-specific equipment and consumables. We will continue to serve the new surfacing needs of customers from all walks of industry and location by providing total solutions.



Thermal Spray Materials

In today's world of increasing demand for resource conservation and higher efficiency, there is growing need for highly functional films across a wide range of products such as aircraft, semiconductors and general industrial equipment, thus broader use of thermal spray films is anticipated. In recent years, attention has turned to new technologies where the keywords are lower temperatures and micronization, as a means for enhancing the efficiency and quality of thermal spray processing. In a move to meet these market expectations, we are stepping up our development of thermal spray materials appropriate for these new technologies.

Core Technologies, Production Technologies

This section focuses on reinforcing Fujimi's strengths in core technologies. By promoting the development of technologies mainly involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, the section will accelerate product development, target greater functionality and help expand the Company's operations into new fields of business.

暮らしの中のフジミ

Fujimi's Products and Technology in Everyday Life

フジミの製品は、生活のなかの様々な物に使われています。
Fujimi's products are used for various items that people see and use in everyday life.



飛行機 Aircraft

フラップ・スラット
レールに溶射材が
使われています。
Thermal Spray materials
are used for flap-slat
rails.



ココにも
FUJIMI

ココにも FUJIMI 鉄道 Railroads

車両の中の IC チップ製造
過程で FO、GLANZOX 等
が使われています。
FO and GLANZOX are used
for IC chips placed in the
rolling stock.



ココにも FUJIMI 信号機 Traffic lights

サファイア基板を
磨く過程で COMPOL
が使われています。
COMPOL is used for
sapphire substrates
placed in led lamps.



ココにも
FUJIMI

ココにも FUJIMI スマートフォン Smartphones

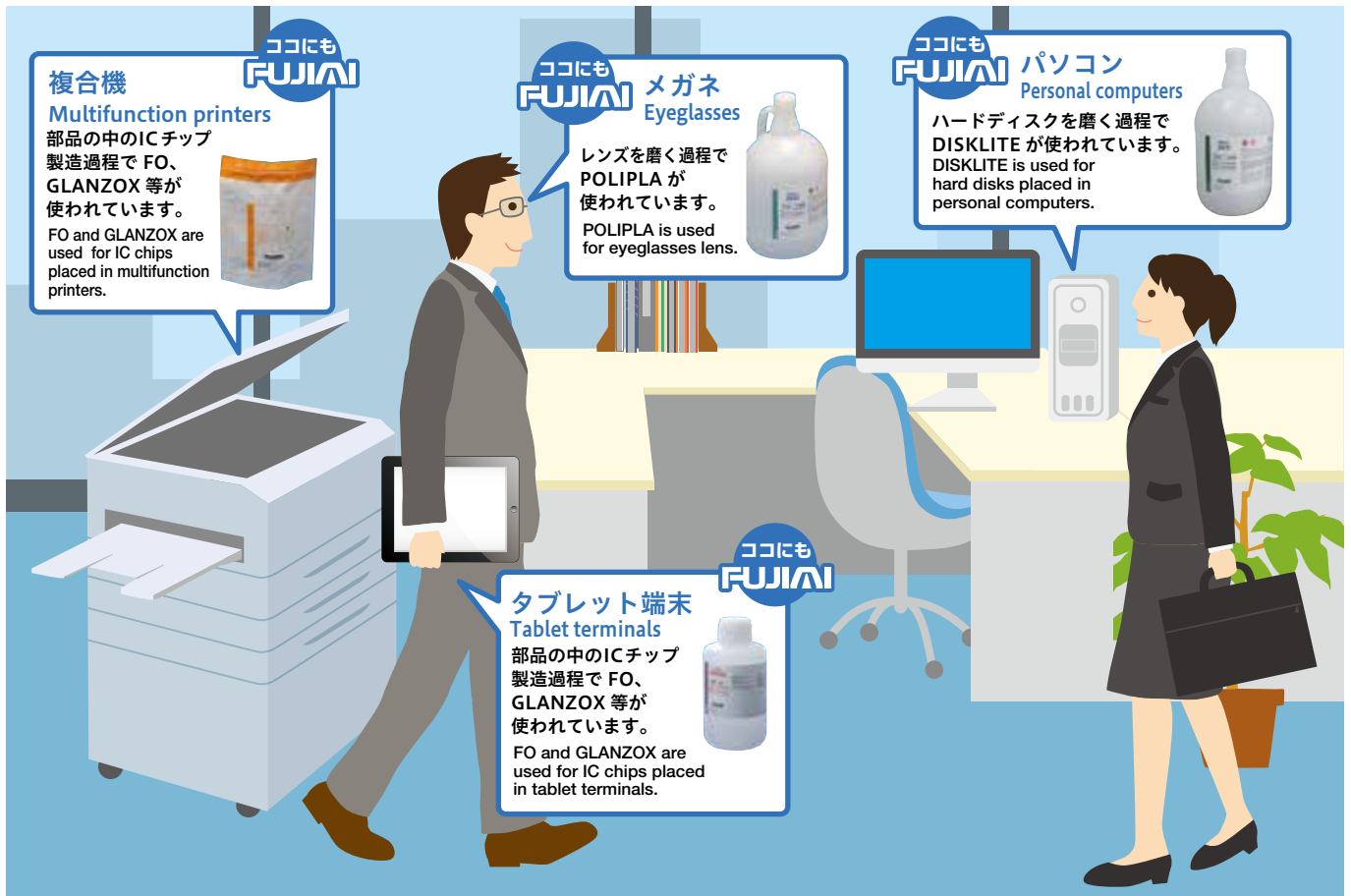
部品の中の水晶振動子
製造過程で GC が使われて
います。
GC is used for
the crystal oscillators
placed in smartphones.



ココにも FUJIMI 自動車 Automobiles

ボディを磨くのに
GC、WA が使われています。
GC and WA are used for
automobile bodies.





ココにも FUJIMI

複合機
Multifunction printers

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX 等が使われています。
FO and GLANZOX are used for IC chips placed in multifunction printers.

ココにも FUJIMI

メガネ
Eyeglasses

レンズを磨く過程で POLIPLA が使われています。
POLIPLA is used for eyeglasses lens.

ココにも FUJIMI

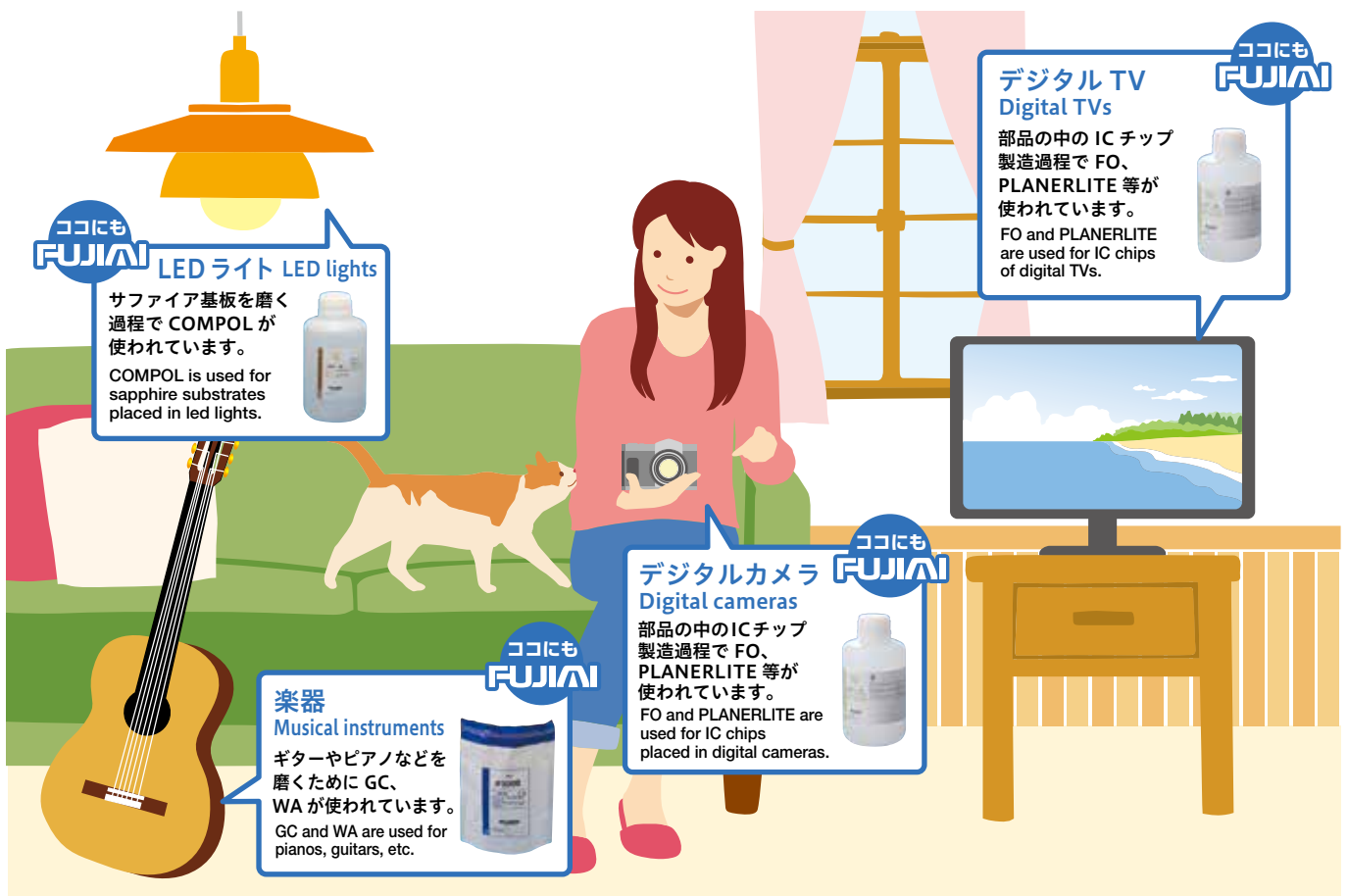
パソコン
Personal computers

ハードディスクを磨く過程で DISKLITE が使われています。
DISKLITE is used for hard disks placed in personal computers.

ココにも FUJIMI

タブレット端末
Tablet terminals

部品の中のICチップ製造過程で FO、GLANZOX 等が使われています。
FO and GLANZOX are used for IC chips placed in tablet terminals.



ココにも FUJIMI

LEDライト LED lights

サファイア基板を磨く過程で COMPOL が使われています。
COMPOL is used for sapphire substrates placed in led lights.

ココにも FUJIMI

デジタルTV
Digital TVs

部品の中の IC チップ製造過程で FO、PLANERLITE 等が使われています。
FO and PLANERLITE are used for IC chips of digital TVs.

ココにも FUJIMI

デジタルカメラ
Digital cameras

部品の中のICチップ製造過程で FO、PLANERLITE 等が使われています。
FO and PLANERLITE are used for IC chips placed in digital cameras.

ココにも FUJIMI

楽器
Musical instruments

ギターやピアノなどを磨くために GC、WA が使われています。
GC and WA are used for pianos, guitars, etc.

製造工程の中のフジミ

Fujimi's Products are used for Manufacturing

半導体デバイス製造に使われるフジミの製品

Fujimi's products used for semiconductor device production

シリコンインゴットの切断 Cutting the silicon ingot

ワイヤーソーでの切断 Cutting by a wire saw

研磨材 Abrasives

フジミの研磨材はココで使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

単結晶シリコンインゴットをウェハーにスライスします。
Single crystal silicon ingot is sliced into wafers.

ウェハー研磨 Wafer polishing

研磨材 Abrasives

ウェハー Wafer

フジミの研磨材はココで使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

微細回路を形成する為に、シリコンウェハー表面を鏡面状に磨き上げます。
The surfaces of wafer are mirror finished so that microcircuits can be formed.

フォトリソグラフィ工程 Photolithography process

フォトレジスト Photoresist

薄膜 Thin film

ウェハー Wafer

高速回転 High-speed rotation

ウェハー Wafer

光源 Light source

照明系レンズ Illumination lens

フォトマスク Photomask

投影レンズ Projection lens

移動 Move

ステージ Stage

移動 Move

フォトレジスト（感光剤）をウェハー表面に塗布し、回路パターンが描かれたフォトマスクをウェハーに焼きつけます。その後、いらぬ酸化膜やレジストをエッチングして取り除くとパターンの完成です。
Photoresist (photosensitizing agent) is applied to the wafer surface and the circuit pattern-printed photomask is baked onto the wafer. Afterwards, oxide film and resist are removed by etching to complete the pattern.

繰り返し Repetition

CMP 工程 CMP process

スラリーを流しながら、スピンドルに貼り付け固定されたウェハーの表面を、研磨テーブル表面の研磨パッドに接触させて研磨します。
While slurry is being poured, the surface of the wafer, which is attached and fixed to a spindle, is polished by contacting it with the polishing pad mounted on the surface of a polishing table.

スピンドル Spindle

ウェハー Wafer

研磨パッド Abrasive pad

CMP スラリー CMP slurry

スラリー Slurry

シリカ粒子 Silica particle

フジミの研磨材はココで使われます。
Fujimi's abrasives are used here.

堆積された絶縁膜やパターン（配線）の凹凸を CMP によって平坦化します。
The irregularities of accumulated insulation films and patterns (wires) are flattened in the CMP process.

この工程を 12~14 回繰り返し、多層配線を形成します。
This process is repeated 12 to 14 times to form multi-layer interconnections.

保護膜 Protective Coating

5メタル 5th Metal Layer

層間絶縁膜 Interlayer Dielectric Film

4メタル 4th Metal Layer

ビアホール Via Hole 3メタル 3rd Metal Layer

コンタクトホール Contact Hole 2メタル 2nd Metal Layer

1メタル 1st Metal Layer

Wプラグ(埋込) W Plug (imbedded)

シリコンウェハー Silicon Wafer

組み立て Assembling

シリコンウェハー Wafer

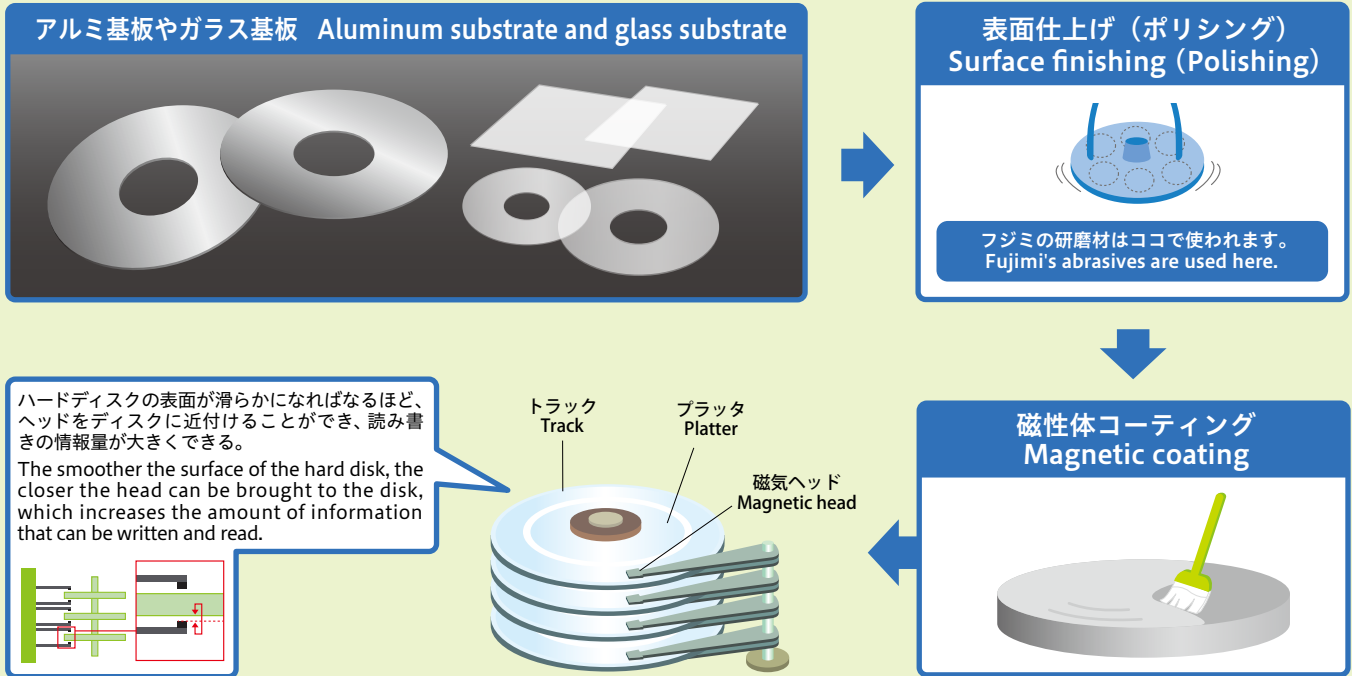
ICチップ IC chip

パッケージ Package

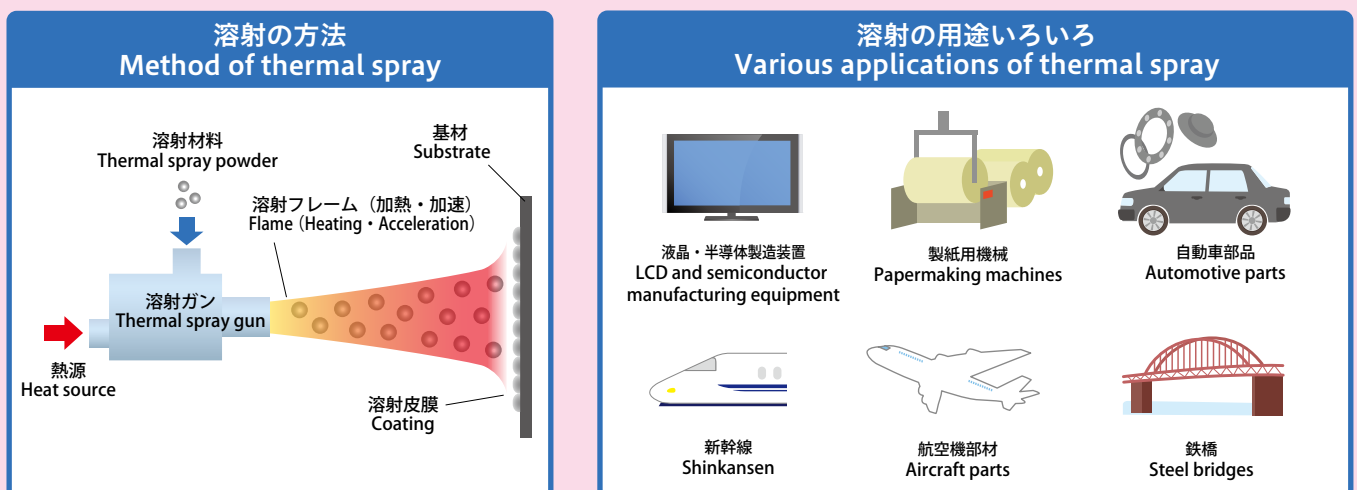
リードフレーム Lead frame

ウェハーをチップに切り分け、パッケージングして出荷します。
The wafer is cut into pieces and shipped after packaging.

ハードディスクの構造 Structure of hard disks



溶射と色々な用途 Thermal spray and various applications



溶射材料を溶射フラームに投入し、基材へ衝突、堆積させることで機能性皮膜を作製する。
Thermal spray powder is supplied into the flame, then deposited on the substrate to form functional coatings.

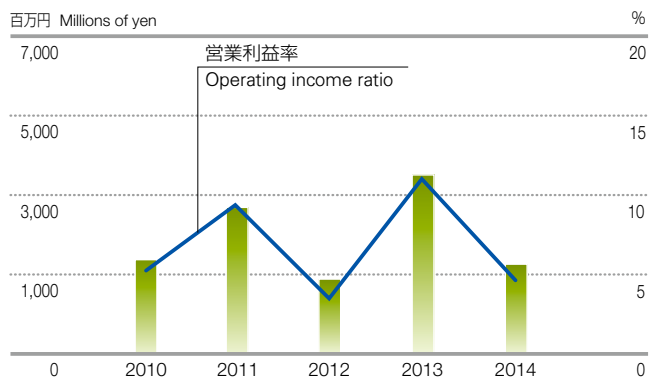
過酷な条件下で使用される機械部品や構造物を熱や腐食、摩耗から守り、長持ちさせる目的で使われる溶射材。その用途は、鉄道や液晶・半導体製造装置や発電に利用されるガスタービン、製紙用機械や鉄橋など多岐にわたっています。
Thermal spray is used to protect machine parts and structures that are used under extreme conditions against heat, corrosion, and abrasion, and to make them durable. Thermal spray is applied to a variety of fields including railroads, LCD and semiconductor manufacturing equipment, gas turbines for power generation, papermaking machines and steel bridges.

経営指標 Selected Financial Data

収益性 Profitability

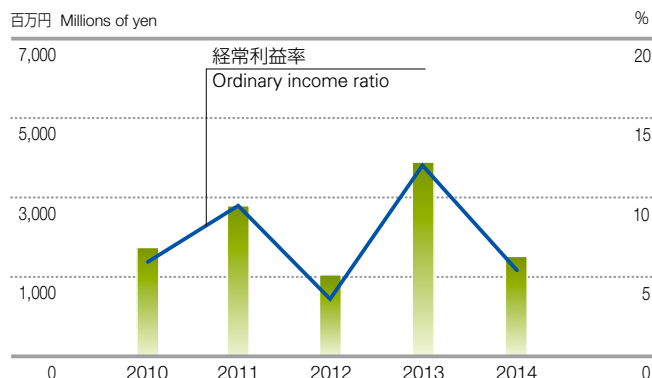
営業利益/営業利益率

Operating Income and Operating Income Ratio



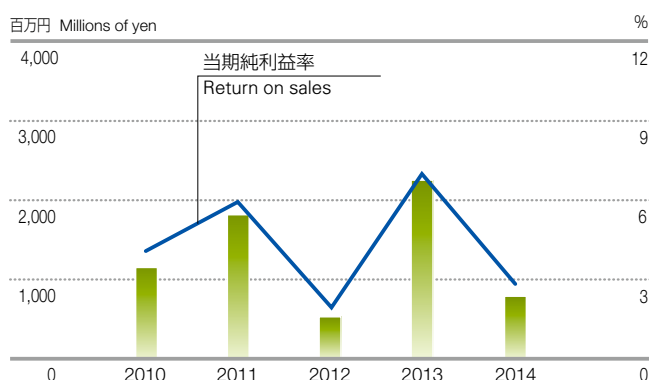
経常利益/経常利益率

Ordinary Income and Ordinary Income Ratio



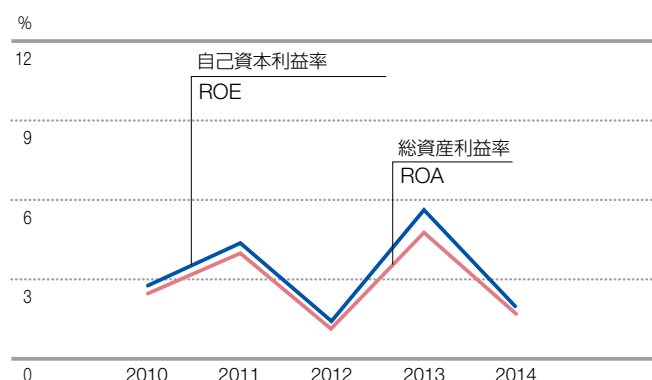
当期純利益/当期純利益率

Net Income and Return on Sales



自己資本利益率/総資産利益率

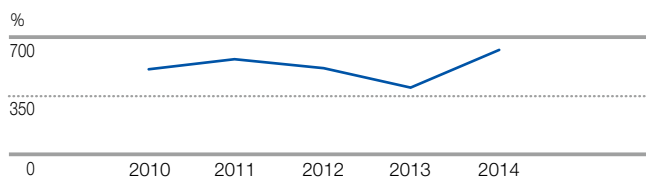
Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)



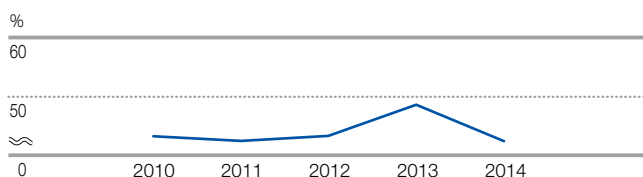
Fiscal years ended March 31				平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期
				2010	2011	2012	2013	2014
売上高	百万円	Net sales	Millions of yen	28,177	30,869	27,424	32,412	27,492
営業利益	百万円	Operating income	Millions of yen	1,496	2,777	953	3,496	1,300
営業利益率	%	Operating income ratio	%	5.3	9.0	3.5	10.8	4.7
経常利益	百万円	Ordinary income	Millions of yen	1,699	2,817	1,038	3,843	1,535
経常利益率	%	Ordinary income ratio	%	6.0	9.1	3.8	11.9	5.6
当期純利益	百万円	Net income	Millions of yen	1,161	1,820	543	2,222	799
当期純利益率	%	Return on sales	%	4.1	5.9	2.0	6.9	2.9
自己資本利益率 (ROE)	%	Return on equity	%	2.8	4.5	1.4	5.6	1.9
総資産利益率 (ROA)	%	Return on assets	%	2.5	3.9	1.2	4.7	1.7

安定性 Stability

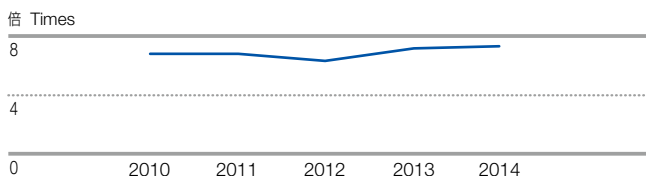
流動比率 Current Ratio



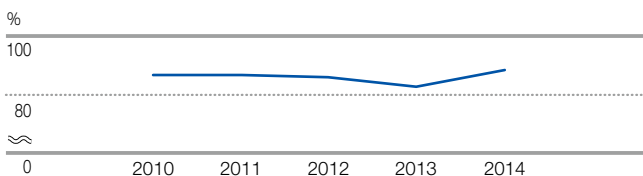
固定比率 Non-current Assets Ratio



手元流動性比率 Short-Term Liquidity



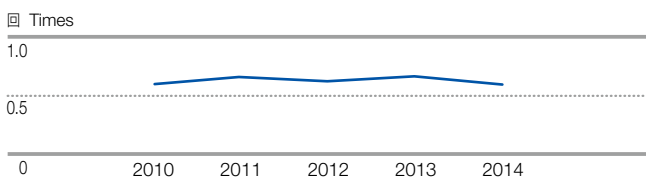
自己資本比率 Equity Ratio



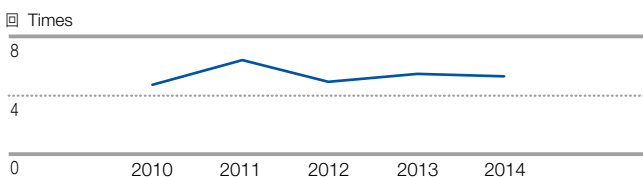
Fiscal years ended March 31				平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
流動比率	%	Current ratio	%	513.8	531.9	516.1	395.1	634.3
固定比率	%	Non-current assets ratio	%	43.3	40.3	41.4	42.6	40.4
手元流動性比率	倍	Short-term liquidity	Times	6.9	6.9	6.5	7.1	7.8
自己資本比率	%	Equity ratio	%	86.7	86.7	86.4	83.1	88.9

生産性 / 効率性 Productivity and Efficiency

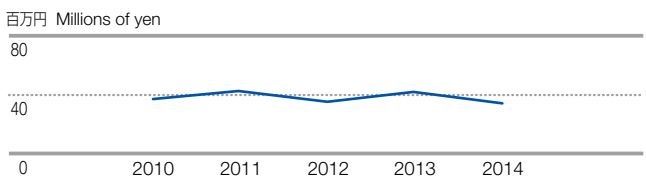
総資産回転率 Asset Turnover



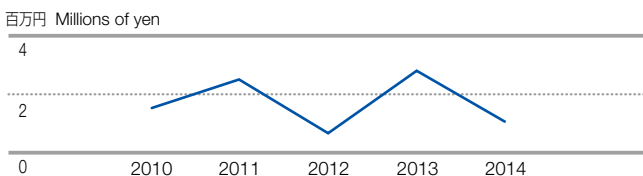
たな卸資産回転率 Inventory Turnover



従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



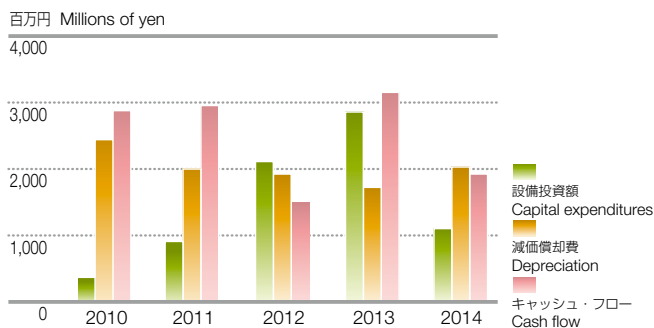
従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee



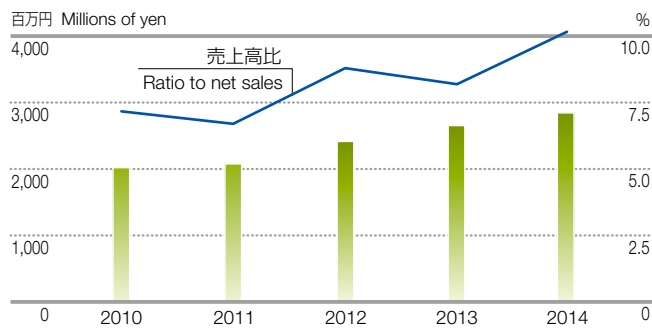
Fiscal years ended March 31				平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
総資産回転率	回	Asset turnover	Times	0.60	0.66	0.62	0.66	0.59
たな卸資産回転率	回	Inventory turnover	Times	4.73	6.35	4.86	5.36	5.01
従業員1人当たり売上高	百万円	Net sales per employee	Millions of yen	38.28	41.60	36.08	41.39	35.47
従業員1人当たり当期純利益	百万円	Net income per employee	Millions of yen	1.58	2.45	0.71	2.84	1.03
従業員数	人	Number of employees		736	742	760	783	775

設備投資 / 研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

設備投資額/減価償却費/キャッシュ・フロー Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/売上高比 R&D Expenses and Ratio to Net Sales



Fiscal years ended March 31				平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
設備投資額	百万円	Capital expenditures	Millions of yen	363	924	2,116	2,856	1,094
減価償却費	百万円	Depreciation	Millions of yen	2,448	1,991	1,921	1,713	2,022
キャッシュ・フロー * 1	百万円	Cash flow	Millions of yen	2,880	2,949	1,492	3,157	1,913
研究開発費	百万円	R&D expenses	Millions of yen	2,025	2,109	2,415	2,638	2,885
売上高比	%	Ratio to net sales	%	7.19	6.83	8.81	8.14	10.50

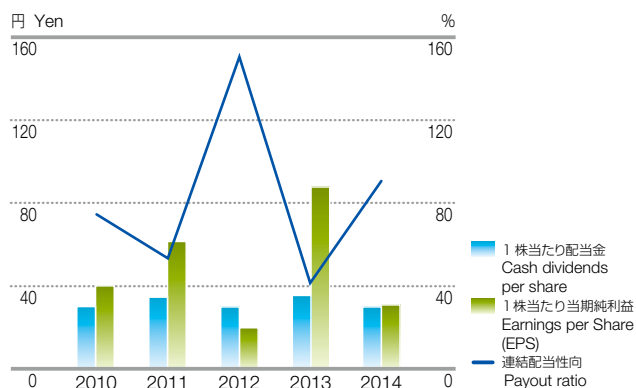
* 1 キャッシュ・フロー = 当期純利益 + 減価償却費 - 配当金

Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends

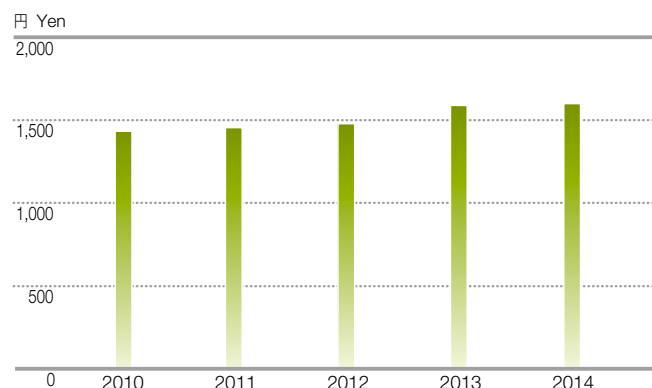
投資指標 Per Share Data and Others

1株当たり配当金/連結配当性向 Cash Dividends per Share, Payout Ratio

1株当たり当期純利益 Earnings per Share (EPS)



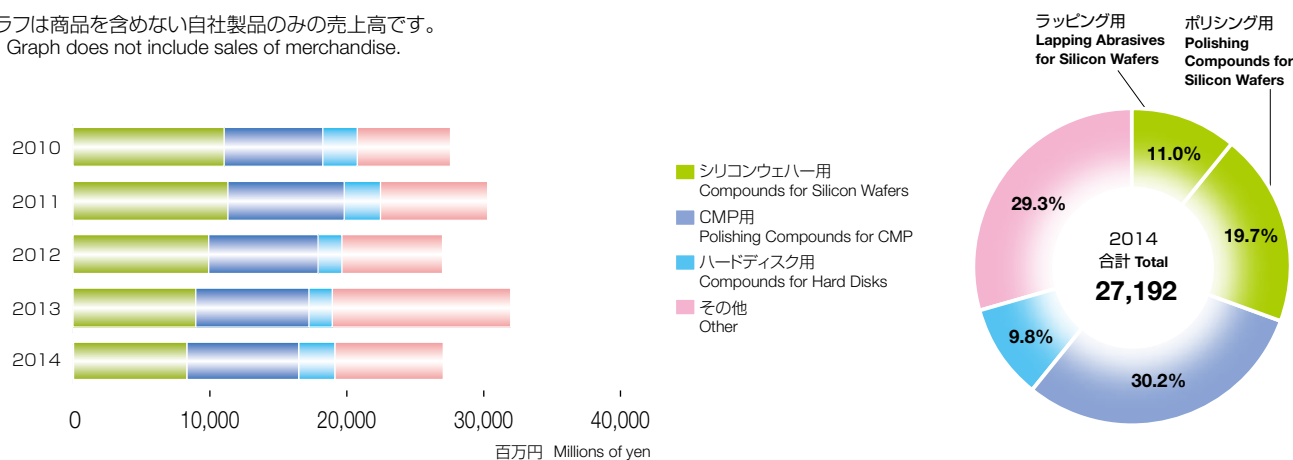
1株当たり純資産 Book Value per Share (BPS)



Fiscal years ended March 31				平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
1株あたり配当金	円	Cash dividends per share	Yen	30.00	35.00	30.00	35.00	30.00
連結配当性向	%	Payout ratio	%	75.0	54.8	150.7	40.9	97.3
1株当たり当期純利益 (EPS)	円	Earnings per share	Yen	39.98	63.82	19.91	85.68	30.82
1株当たり純資産 (BPS)	円	Book value per share	Yen	1,432.59	1,450.83	1,478.56	1,579.79	1,598.32

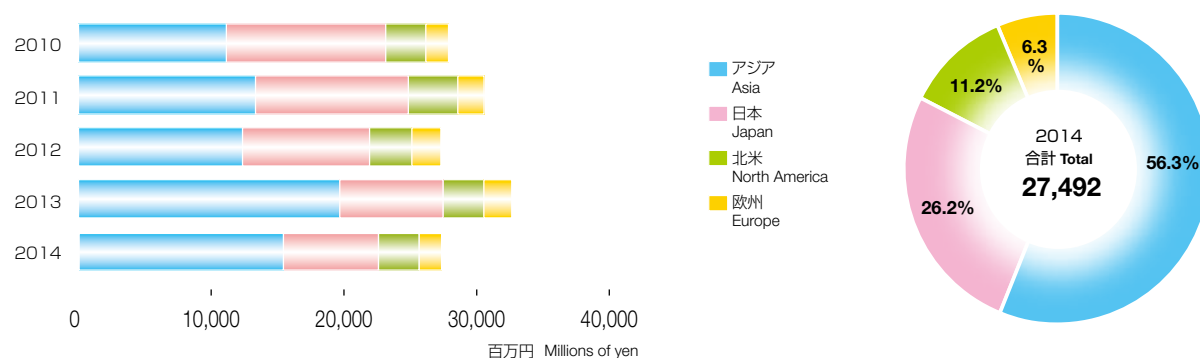
用途別製品売上高 Sales by Application

* グラフは商品を含めない自社製品のための売上高です。
Note: Graph does not include sales of merchandise.



Fiscal years ended March 31		平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期	平成25年 3月期	平成26年 3月期
百万円 Millions of yen		2010	2011	2012	2013	2014
シリコンウェハー用	Compounds for Silicon Wafers	11,037	11,656	9,907	8,973	8,330
CMP用	Polishing Compounds for CMP	7,262	8,532	8,029	8,323	8,224
ハードディスク用	Compounds for Hard Disks	2,570	2,689	1,788	1,826	2,658
その他	Other	6,855	7,528	7,388	13,054	7,980
合計	Total	27,726	30,407	27,114	32,178	27,192

地域別売上高 Sales by Region



Fiscal years ended March 31		平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期
百万円 Millions of yen		2010	2011	2012	2013	2014
アジア	Asia	11,256	13,469	12,389	19,542	15,490
日本	Japan	12,076	11,579	9,568	7,696	7,208
北米	North America	3,126	3,829	3,282	3,046	3,075
欧州	Europe	1,718	1,990	2,183	2,127	1,718
合計	Total	28,177	30,869	27,424	32,412	27,492

連結貸借対照表

Consolidated Balance Sheet

百万円 Millions of yen

As of March 31		平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
資産の部	Assets					
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and deposits	13,835	12,468	9,490	14,023	12,709
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	8,027	6,820	6,504	6,021	5,780
有価証券	Securities	2,303	5,303	5,301	5,109	5,106
たな卸資産	Inventories	4,676	5,048	6,241	5,856	5,107
繰延税金資産	Deferred tax assets	751	632	434	610	393
その他	Other current assets	133	279	574	285	825
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(110)	(157)	(41)	(31)	(25)
流動資産合計	Total current assets	29,617	30,396	28,506	31,877	29,898
固定資産	Non-current assets					
有形固定資産	Property, plant and equipment					
建物及び構築物	Buildings and structures	7,568	6,963	6,782	8,197	7,779
機械装置及び運搬具	Machinery equipment and vehicles	3,181	2,345	2,062	2,130	1,665
土地	Land	3,400	3,391	3,392	3,402	3,410
建設仮勘定	Construction in progress	89	58	818	204	167
その他	Other property, plant and equipment	999	1,160	913	1,510	1,547
有形固定資産合計	Total property, plant and equipment	15,239	13,919	13,970	15,445	14,570
無形固定資産	Intangible assets	331	305	462	608	593
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment securities	253	98	99	115	126
繰延税金資産	Deferred tax assets	82	95	48	18	176
その他	Other investments and other assets	1,954	1,929	1,493	1,470	1,515
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(16)	(9)	(199)	(198)	(232)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	2,273	2,113	1,442	1,406	1,586
固定資産合計	Total non-current assets	17,844	16,338	15,875	17,460	16,750
資産合計	Total assets	47,462	46,734	44,381	49,337	46,648

As of March 31		平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
負債の部	Liabilities					
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable	3,335	2,905	3,082	3,173	2,713
短期借入金	Short-term loans payable	184	81	41	—	—
未払法人税等	Income taxes payable	476	476	14	1,605	56
賞与引当金	Provision for bonuses	456	595	612	679	554
その他	Other current liabilities	1,310	1,655	1,773	2,610	1,389
流動負債合計	Total current liabilities	5,763	5,714	5,523	8,068	4,713
固定負債	Non-current liabilities					
長期借入金	Long-term loans payable	161	61	—	—	—
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	5	8	33	31	13
退職給付引当金	Provision for retirement benefits	98	120	147	172	—
退職給付に係る負債	Net defined benefit liability	—	—	—	—	389
その他	Other non-current liabilities	5	27	32	34	23
固定負債合計	Total non-current liabilities	271	217	214	238	427
負債合計	Total liabilities	6,035	5,932	5,737	8,307	5,140
純資産の部	Net assets					
株主資本	shareholders' equity					
資本金	Capital stock	4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	5,069	5,069	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	Retained earnings	35,111	36,069	35,716	37,160	37,052
自己株式	Treasury shares	(2,764)	(3,792)	(5,711)	(5,711)	(5,711)
株主資本合計	Total shareholders' equity	42,170	42,100	39,828	41,272	41,163
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	(998)	(1,565)	(1,475)	(294)	295
新株予約権	Subscription rights to shares	63	61	59	52	48
少数株主持分	Minority interests	191	205	231	—	—
純資産合計	Total net assets	41,426	40,802	38,643	41,030	41,507
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	47,462	46,734	44,381	49,337	46,648

連結損益計算書

Consolidated Statement of Income

百万円 Millions of yen

Fiscal years ended March 31		平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		3月期	3月期	3月期	3月期	3月期
		2010	2011	2012	2013	2014
売上高	Net sales	28,177	30,869	27,424	32,412	27,492
売上原価	Cost of sales	20,573	21,362	19,399	21,116	18,262
売上総利益	Gross profit	7,604	9,506	8,024	11,295	9,230
販売費及び一般管理費	Selling, general and administrative expenses	6,107	6,729	7,070	7,798	7,929
営業利益	Operating income	1,496	2,777	953	3,496	1,300
営業外収益	Non-operating income					
受取利息	Interest income	50	54	60	70	62
その他	Other Non-operating income	174	71	75	326	215
営業外収益合計	Total of non-operating income	225	125	136	396	277
営業外費用	Non-operating expenses					
支払利息	Interest expenses	16	12	5	0	—
その他	Other Non-operating expenses	6	72	46	49	42
営業外費用合計	Total of non-operating expenses	22	85	51	50	42
経常利益	Ordinary income	1,699	2,817	1,038	3,843	1,535
特別利益	Extraordinary income					
固定資産売却益	Gain on Sales of non current assets	1	3	2	—	—
その他	Other extraordinary income	219	51	3	6	3
特別利益合計	Total of extraordinary income	220	54	6	6	3
特別損失	Extraordinary losses					
固定資産除売却損	Loss on sales and retirement of non-current assets	45	65	15	—	—
減損損失	Impairment loss	403	—	—	—	253
その他	Other extraordinary loss	3	42	48	—	—
特別損失合計	Total of extraordinary losses	452	107	63	—	253
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	1,467	2,764	980	3,849	1,285
法人税、住民税及び事業税	Income taxes—current	546	828	157	1,754	384
法人税等調整額	Income taxes—deferred	(255)	97	260	(152)	100
少数株主利益	Minority interests in income	14	17	19	25	—
当期純利益	Net income	1,161	1,820	543	2,222	799

連結包括利益計算書

Statement of Consolidated Comprehensive Income

百万円 Millions of yen

Fiscal years ended March 31		平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
		3月期	3月期	3月期	3月期	3月期
		2010	2011	2012	2013	2014
少数株主損益調整前当期利益	Income before minority interests		1,837	562	2,247	799
その他の包括利益	Other comprehensive income					
その他有価証券評価差額金	Valuation difference on available-for-sale securities		(47)	2	11	2
為替換算調整勘定	Foreign currency translation adjustment		(522)	(88)	1,204	680
その他の包括利益合計	Total of other comprehensive income		(569)	(85)	1,216	682
包括利益	Comprehensive income		1,267	476	3,464	1,482
内訳	Breakdown					
親会社株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to owners of parent		1,253	462	3,403	1,482
少数株主に係る包括利益	Comprehensive income attributable to minority interests		14	14	60	—

* 連結包括利益計算書は平成23年3月期から * Statement of consolidated comprehensive income started from the fiscal year ended March 31, 2011.

連結キャッシュ・フロー計算書

Consolidated Statement of Cash Flows

百万円 Millions of yen

		Fiscal years ended March 31				
		平成22年 3月期 2010	平成23年 3月期 2011	平成24年 3月期 2012	平成25年 3月期 2013	平成26年 3月期 2014
営業活動によるキャッシュ・フロー		Cash flows from operating activities				
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes and minority interests	1,467	2,764	980	3,849	1,285
減価償却費	Depreciation	2,448	1,991	1,921	1,713	2,022
減損損失	Impairment loss	403	—	—	—	253
売上債権増減額（増加）	Decrease (increase) in notes and accounts receivable	(2,081)	1,036	130	697	394
仕入債務増減額（減少）	Increase (decrease) in notes and accounts payable	856	(289)	26	(89)	(608)
たな卸資産増減額（増加）	(Increase) decrease in inventories	2,656	(561)	(1,161)	644	945
その他	Other	193	173	98	591	(813)
小計	Subtotal	5,944	5,115	1,996	7,407	3,479
利息及び配当金の受取額	Interest and dividend received income	51	68	64	66	77
利息の支払額	Interest expenses paid	(16)	(13)	(5)	(0)	—
法人税等の支払額	Income taxes paid	(135)	(837)	(892)	(233)	(2,512)
法人税等の還付額	Income taxes refunded	791	9	—	345	—
その他	Other	131	—	—	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by operating activities	6,768	4,342	1,162	7,585	1,044
投資活動によるキャッシュ・フロー		Cash flows from investing activities				
定期預金の預入による支出	Payments into time deposits	(1,500)	(1,505)	(2,615)	(3,017)	(2,223)
定期預金の払戻による収入	Proceeds from withdrawal of time deposits	150	1,500	2,508	2,912	2,517
有価証券の取得による支出	Purchase of securities	—	—	(800)	(3,106)	(4,107)
有価証券の償還による収入	Proceeds from redemption of securities	99	—	—	1,300	4,100
有形固定資産取得による支出	Purchase of property, plant and equipment	(256)	(508)	(1,707)	(2,370)	(1,597)
その他	Other	(87)	(42)	(262)	(622)	(139)
投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by investing activities	(1,594)	(471)	(2,876)	(4,904)	(1,450)
財務活動によるキャッシュ・フロー		Cash flows from financing activities				
長期借入金の返済による支出	Repayments of long-term loans payable	(93)	(87)	(79)	(41)	—
配当金の支払額	Cash dividends paid	(729)	(862)	(971)	(778)	(907)
その他	Other	(627)	(1,123)	(1,929)	(7)	(8)
財務活動によるキャッシュ・フロー	Net cash provided by financing activities	(1,450)	(2,073)	(2,980)	(827)	(916)
現金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and cash equivalents	17	(171)	(146)	576	303
現金及び現金同等物の増加（減少）額	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	3,740	1,626	(4,841)	2,429	(1,019)
現金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of period	10,899	14,639	16,265	11,579	14,009
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	Increase in cash/cash-equivalent resulting from changes in the accounting period of affiliated	—	—	155	—	—
現金及び現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents at end of period	14,639	16,265	11,579	14,009	12,990

会社データ

Corporate Data

商号 Name	株式会社フジミインコーポレーテッド FUJIMI INCORPORATED
設立年月日 Date of establishment	1953年(昭和28年)3月20日 March 20, 1953
資本金 Paid-in capital	¥4,753,438,500
上場市場 Securities traded	東京証券取引所第一部 Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384
従業員数 Number of employees	775 (個別 Non-Consolidated 557)

役員 Board of Directors

2014年(平成26年)6月24日現在 (As of June 24, 2014)

代表取締役社長 President	関 敬史 Keishi Seki
常務取締役 Director	伊藤 広一 Hirokazu Ito
取締役 Director	鈴木 彰 Akira Suzuki
取締役 Director	大脇 寿樹 Toshiki Owaki
取締役 Director	鈴木 勝弘 Katsuhiro Suzuki
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	松島 伸男 Nobuo Matsushima
常勤監査役 Standing Corporate Auditor	藤川 佳明 Yoshiaki Fujikawa
監査役 Corporate Auditor	高橋 正彦 Masahiko Takahashi
監査役 Corporate Auditor	川下 政美 Masami Kawashita

沿革 History

日付	内容	Date	Event
1950年(昭和25年)8月	不二見研磨材工業所を創立し、人造精密研磨材の生産を開始	August 1950	Founded Fujimi Abrasives and started production of synthetic precision abrasives.
1953年(昭和28年)3月	不二見研磨材工業株式会社を設立	March 1953	Established Fujimi Abrasives Manufacturing Co., Ltd.
1957年(昭和32年)	東京通信工業(株)(現ソニー(株))のゲルマニウム半導体基盤用研磨材ニーズに対応	1957	Supplied lapping abrasives for germanium semiconductor substrates to Tokyo Tsushin Kogyo, the predecessor of Sony Corporation.
1967年(昭和42年)7月	シリコンウェハー用ポリシング材[GLANZOX]を発表	July 1967	Announced the development of GLANZOX polish for silicon wafers.
1977年(昭和52年)1月	プラスチックレンズ用研磨材[POLIPLA]を生産開始	January 1977	Began manufacturing POLIPLA plastic lens polishing compounds.
1981年(昭和56年)	[COMPOL]シリーズを開発	1981	Developed the "COMPOL" series.
1988年(昭和63年)9月	超高純度のシリコンウェハー用ポリシング材[GLANZOX3900]を開発	September 1988	Developed GLANZOX-3900 as an ultra-high-purity polishing compound for silicon wafers.
1990年(平成2年)11月	ディスク用ポリシング材[DISKLITE]シリーズを開発	November 1990	Developed the DISKLITE series, the first polishing compounds developed especially for memory disks.
1995年(平成7年)4月	CMP用スラリー[PLANERLITE]シリーズを開発	April 1995	Developed the PLANERLITE series of CMP slurries.
2000年(平成12年)12月	CMPスラリー(Cu用)[PLANERLITE-7000]シリーズを開発	December 2000	Developed the PLANERLITE-7000, a new slurry series for Cu CMP.
2001年(平成13年)1月	耐衝撃WCサーメット溶射材[SURPREX W2010X]を発表	January 2001	Introduced the SURPREX-W2010X, new WC cermet thermal spraying composites of enhanced impact resistance.
2002年(平成14年)3月	FUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2002	FUJIMI AMERICA INC.* won the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2002年(平成14年)10月	世界初、HVOF[高速フレーム溶射]による微粉末溶射システムの確立に成功	October 2002	Successfully developed the world's first ultra-fine-grain thermal spray system employing a high velocity oxy-fuel (HVOF) process.
2003年(平成15年)3月	当社およびFUJIMI AMERICA INC.*がインテル社の「プリファード・クオリティ・サプライヤー(PQS)賞」を受賞	March 2003	FUJIMI INCORPORATED and FUJIMI AMERICA INC.* received the Preferred Quality Supplier Award from Intel.
2004年(平成16年)3月	FUJIMI CORPORATIONが、インテル社の最高位にランクされる「サプライヤー・コンティニュアス・クオリティ・インフラメント(SCQI)賞」を受賞	March 2004	FUJIMI CORPORATION received the Prestigious Supplier Continuous Quality Improvement Award from Intel.
2007年(平成19年)2月	東証一部、名証一部に同時上場	February 2007	Listed Fujimi's shares on the Tokyo Stock Exchange First Section and Nagoya Stock Exchange First Section.
2008年(平成20年)7月	FUJIMI CORPORATIONがAMD社の「World Class Supplier Pathfinder Award 2007」を受賞	July 2008	FUJIMI CORPORATION received the World Class Supplier Pathfinder Award 2007 from AMD.
2009年(平成21年)11月	研磨に適した新しい粒子「角状ナノアルミナ」の開発に成功	November 2009	Successfully developed "angular nano-aluminium" as an abrasive material.
2010年(平成22年)3月	世界初、500℃から成膜可能な超硬溶射材料の開発に成功	March 2010	Successfully developed the world's first tungsten carbide powders applicable to low temperature spray processes of 500°C.
2011年(平成23年)4月	航空・宇宙・防衛 品質マネジメントシステム(JIS Q 9100)認証を取得(溶射材)	April 2011	Obtained JIS Q 9100 quality management certification for aircraft, space and defense (for thermal spray materials).
2013年(平成25年)12月	TSMC社より「Excellent Performance Award(優秀賞)」を受賞	December 2013	FUJIMI INCORPORATED received the Excellent Performance Award from TSMC.

* FUJIMI AMERICA INC.は 2003(平成15年)7月にFUJIMI CORPORATIONと合併し、商号をFUJIMI CORPORATIONに変更しました。

* FUJIMI AMERICA INC. merged with FUJIMI CORPORATION in 2003 July and changed the business name to FUJIMI CORPORATION.

株式情報 Stock Information

大株主一覧 Leading Shareholders

2014年(平成26年)3月31日現在 (As of March 31, 2014)

株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Percentage of Total
株式会社フジミインコーポレーテッド(自己株口)	Fujimi Incorporated (Treasury Stock)	4,760	15.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	2,902	9.4
有限会社コマ	Koma Co., Ltd.	1,638	5.3
野田 純孝	Sumitaka Noda	1,520	4.9
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NVIO1	NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NVIO1	1,197	3.9
特定有価証券信託受託者株式会社 SMBC 信託銀行	SMBC Trust Bank Ltd. Designated Securities Trust	1,141	3.7
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.3
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	709	2.3
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.2
フジミ取引先持株会	Fujimi business partners stock ownership	601	1.9

(注) 所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てしています。

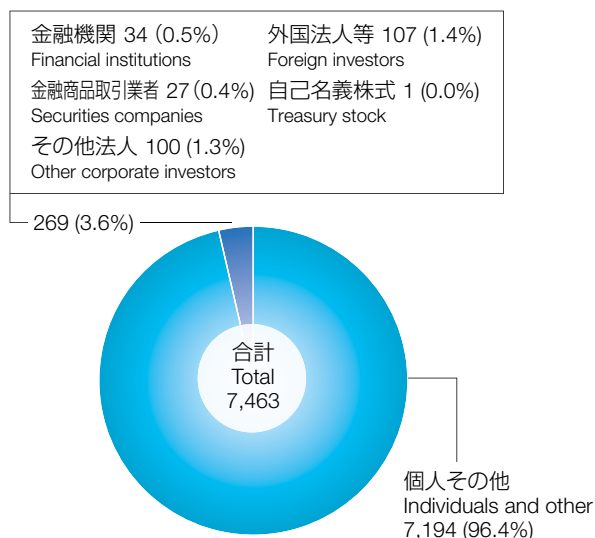
Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is omitted after the second decimal place.

所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

2014年(平成26年)3月31日現在 (As of March 31, 2014)

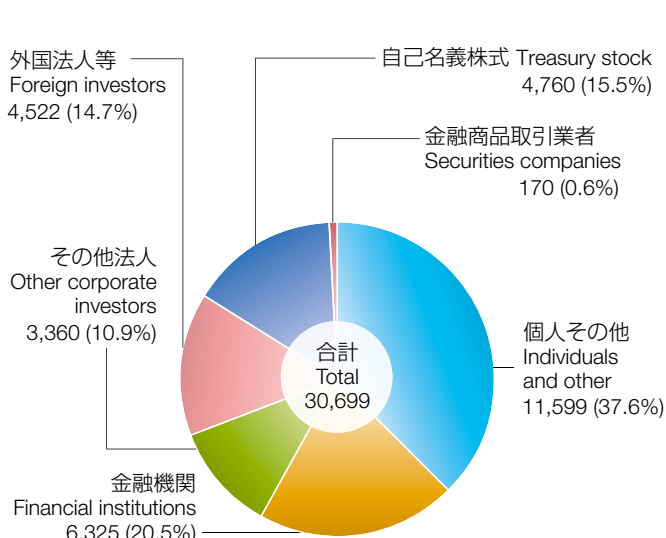
所有者別株主数(人)

Shareholders by Category (Number of Shareholders)



所有者別持株数(千株)

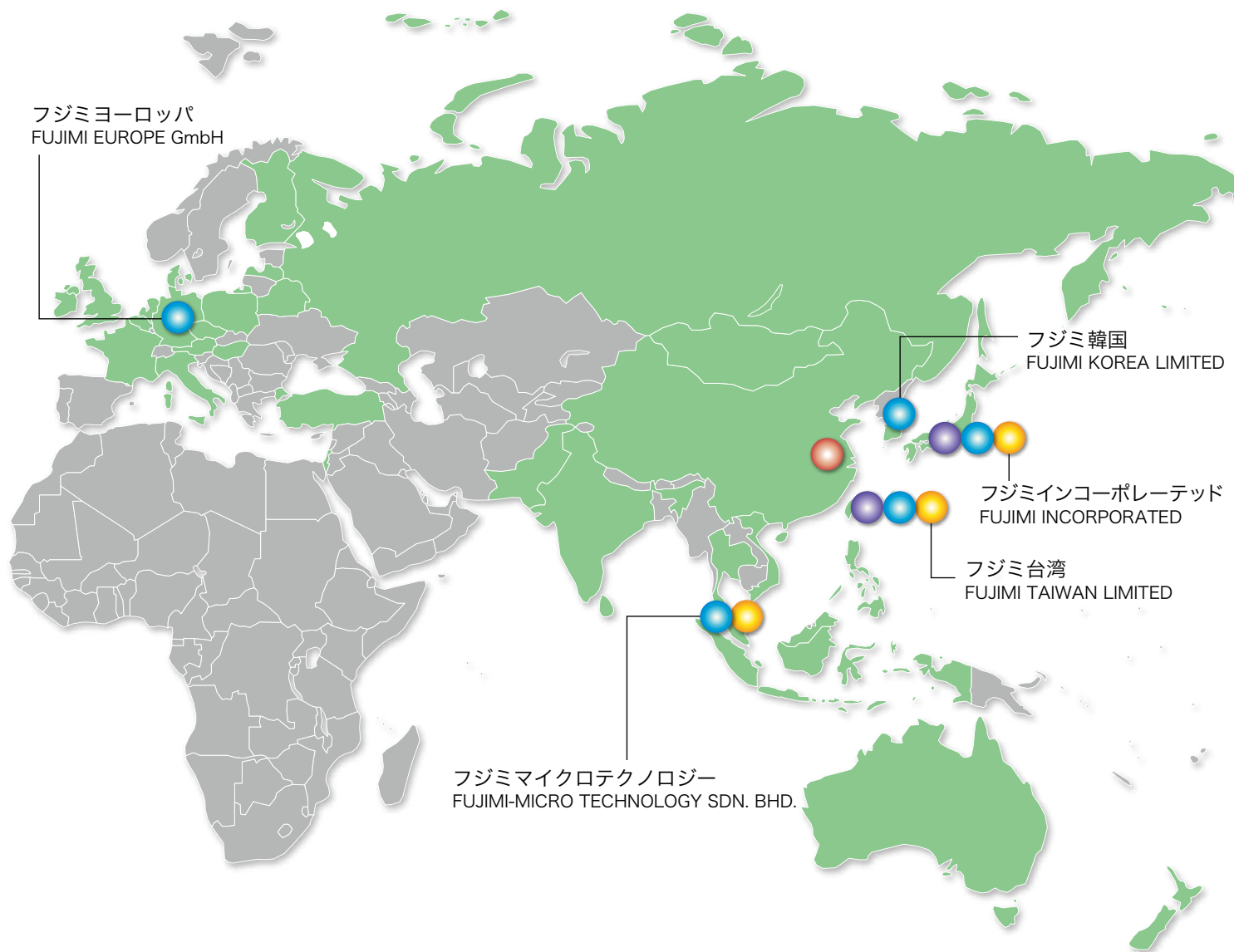
Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



発行済株式の推移 Common Stock Issues

摘要 Type of Issue		発行済株式数(千株) Shares Outstanding after Issue (Thousands of Shares)
1992年(平成4年)2月1日	February 1, 1992 第三者割当増資	Allotment of new shares to third parties 245
1992年(平成4年)11月20日	November 20, 1992 1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split 491
1993年(平成5年)9月27日	September 27, 1993 新株引受権の権利行使	Exercise of warrants 509
1994年(平成6年)5月20日	May 20, 1994 1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split 1,019
1994年(平成6年)8月4日	August 4, 1994 500円額面株式1株を50円額面株式10株に分割	Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500 10,195
1995年(平成7年)4月18日	April 18, 1995 一般公募増資	Public offering of common stock 10,995
1996年(平成8年)5月20日	May 20, 1996 1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split 12,094
1996年(平成8年)10月1日	October 1, 1996 一般公募増資	Public offering of common stock 12,894
1997年(平成9年)5月20日	May 20, 1997 1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split 14,184
1998年(平成10年)5月20日	May 20, 1998 1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split 15,602
2001年(平成13年)11月22日	November 22, 2001 自己株式の利益消却	Treasury stock purchased and retired 15,349
2005年(平成17年)5月20日	May 20, 2005 1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split 30,699

グローバル展開 Global Expansion



事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場 Headquarters · Biwajima Plant
〒452-8502
愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1
Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166
1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu,
Aichi, 452-8502, Japan
Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場 Inazawa Plant
〒492-8329
愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1
1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa,
Aichi, 492-8329, Japan

各務原工場 Kakamigahara Plant
〒504-0927
岐阜県各務原市上戸町 7-1-8
1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara,
Gifu, 504-0927, Japan

各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-62-1
62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,
Gifu, 509-0103, Japan

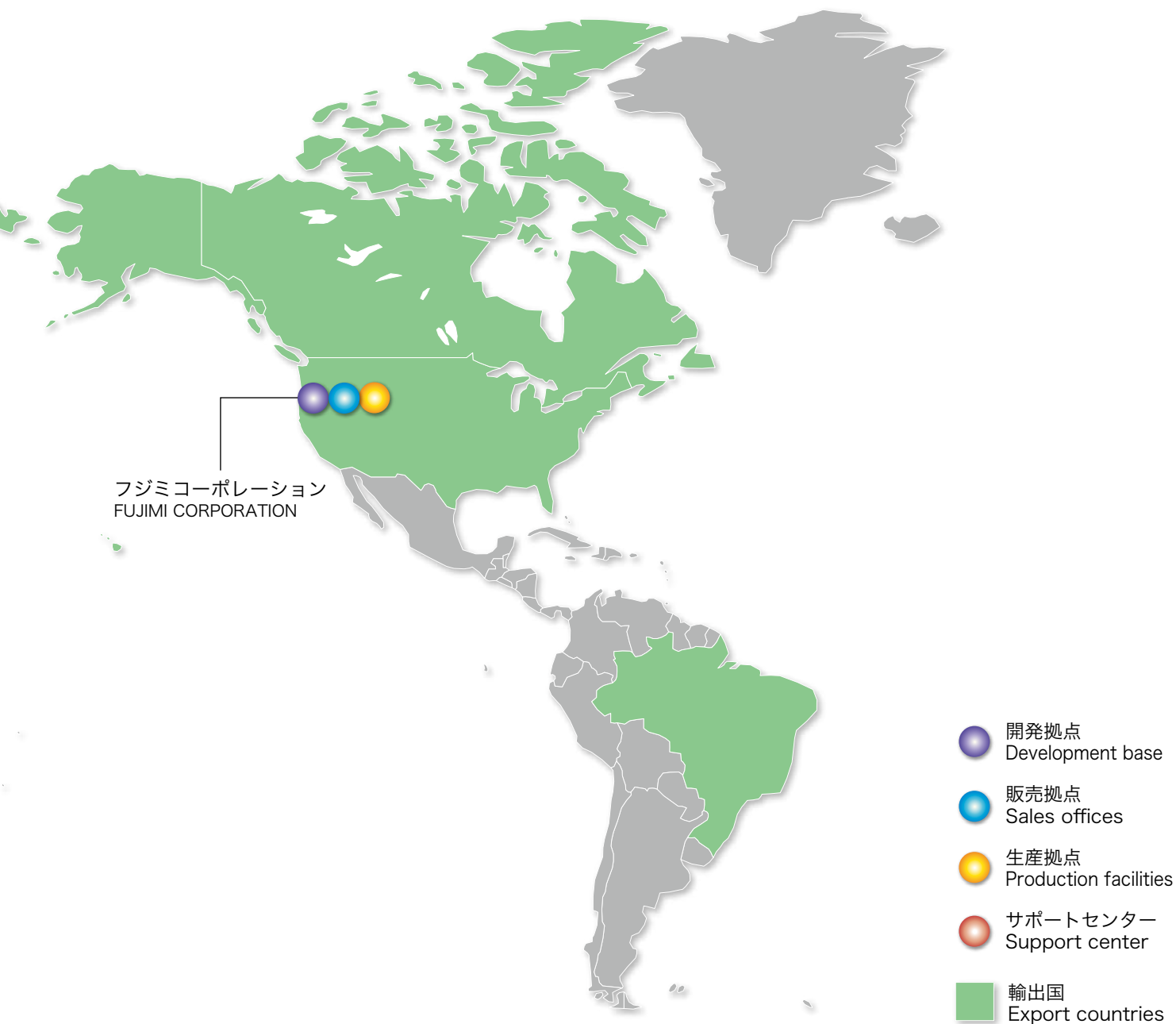
溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department
〒509-0103
岐阜県各務原市各務東町 5-82-28
82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara,
Gifu, 509-0103, Japan

研究開発センター R&D Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8
8, Technoplaza-1, Kakamigahara,
Gifu, 509-0109, Japan

物流センター Logistics Center
〒509-0109
岐阜県各務原市テクノプラザ 4-1
1, Technoplaza-4, Kakamigahara,
Gifu, 509-0109, Japan

東京営業所 Tokyo Office
〒101-0047
東京都千代田区内神田 3-2-8
いちご内神田ビル 7F
7th Floor, ICHIGO Uchikanda Bldg., 2-8,
Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0047, Japan

上海事務所 Shanghai Office
上海市浦東区科苑路 88 号、徳国中心 317B 室
317B, German Center, 88 Keyuan Road,
Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203,
Shanghai, China



連結子会社 Consolidated subsidiary

フジミコーポレーション (米国)

FUJIMI CORPORATION

11200 SW Leveton Drive, Tualatin,
Oregon 97062, U.S.A.

Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

フジミマイクロテクノロジー (マレーシア)

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD.

Unit 3, Level 15, Menara Genesis No. 33,
Jalan Sultan Ismail 50250, Kuala Lumpur, Malaysia

Phone: +60-3-2143-0036 Fax: +60-3-2145-8955

フジミヨーロッパ (ドイツ)

FUJIMI EUROPE GmbH

Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany

Phone: +49-7940-939499-0 Fax: +49-7940-939499-20

フジミ台湾 (台湾)

FUJIMI TAIWAN LIMITED

No.10 Tongke 1st Rd., Tongluo Township,
Miaoli County 366, Taiwan (R.O.C.)

Phone: +886-37-987-123 Fax: +886-37-987-567

フジミ韓国 (韓国)

FUJIMI KOREA LIMITED

RM1203 ParkView, Jungja-Dong 6, BunDang-Gu,
Seongnam-Shi, Kyeonggi-Do, Korea

Phone: +82-31-726-3555 Fax: +82-31-726-3556

FUJIMI

FUJIMI INCORPORATED

株式会社フジミインコーポレーテッド

◆ ホームページをリニューアル

事業内容や会社情報、IR 情報をより充実し、デザインも一新しました。

新しくなりましたホームページを今後ともよろしくお願ひします。

<http://www.fujimiinc.co.jp/>

◆ Remodeling of website

Fujimi's website is remodeled by enhancing the descriptions of our business, corporate information, and IR information.

To see the website, access to the following URL: <http://www.fujimiinc.co.jp/>



◆ 会社案内ビデオをリニューアル

ホームページ内にあります「会社案内ビデオ」が新しくなりました。フジミ製品の活躍の場やグローバル展開など分かりやすく紹介しています。「トップページ⇒フジミについて⇒会社案内ビデオ」にてご覧いただけます。

◆ Remaking of the corporate video

Fujimi's corporate video is remade posted on our website. It introduces our global development and the fields where Fujimi products are used.

To see the corporate video, click "About Us" on the top page of our website and then "Corporate Video."



この印刷物は、環境負荷低減のため古紙パルプを80%使用した環境対応紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しています。